

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 关于对外投资暨签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造 生产线项目之投资合作协议》的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》（该议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过）。2024 年 5 月 21 日，公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”）。具体事项详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资暨签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（公告编号：临 2024-042）。现对上述公告部分内容补充说明如下：

### 一、项目实施主体财务情况

厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”）目前为公司合并报表范围内的全资子公司。士兰集宏截至最近一期（2024 年 4 月 30 日）主要财务数据如下：资产总额为 5,999.31 万元，负债为 4.64 万元，所有者权益为 5,994.67 万元。因其成立于 2024 年 3 月，目前尚未产生主营业务收入，故其主营业务收入为 0，净利润为-5.33 万元。

### 二、本次投资对公司财务状况的影响

若公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次投资事项，公司及协议各方在按照《投资合作协议》完成第一期项目的投资后，公司对士兰集宏的持股比例将由 100%降低至 25.1781%，公司将不再将其纳入合并报表范围，将按照权益法核算对士兰集宏的投资，并按照持股比例 25.1781% 计算确认投资收益。

本次投资，公司拟合计认缴士兰集宏注册资本 10.6 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 4.43%，占最近一期经审计净资产的 7.90%，以上出资预计不会对公司的资产、负债情况产生重大影响。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日